

上海伟测半导体科技股份有限公司

2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和上海证券交易所印发的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》（上证发〔2023〕194 号）的规定，将上海伟测半导体科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“伟测科技”）2023 年度募集资金存放与使用情况专项说明如下。本说明中若明细项目金额加计之和与合计数存在尾差，系四舍五入所致。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于同意上海伟测半导体科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1878 号），本公司由主承销商方正证券承销保荐有限责任公司采用包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,180.27 万股，发行价为每股人民币 61.49 元，共计募集资金 1,340,648,023.00 元，坐扣承销和保荐费用 78,162,309.27 元后的募集资金为 1,262,485,713.73 元，已由主承销商方正证券承销保荐有限责任公司于 2022 年 10 月 21 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除审计及验资费用、律师费用、信息披露费用、发行手续费及其他费用等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 25,306,164.68 元后，公司本次募集资金净额为 1,237,179,549.05 元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资

报告》（天健验〔2022〕6-69号）。

（二）募集资金使用和结余情况

金额单位：人民币万元

项 目	序号	金 额	
募集资金净额	A	123,717.95	
截至期初累计发生额	项目投入	B1	35,430.68
	利息收入净额	B2	287.90
本期发生额	项目投入	C1	88,884.21
	利息收入净额	C2	1,025.56
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1	124,314.89
	利息收入净额	D2=B2+C2	1,313.46
应结余募集资金	E=A-D1+D2	716.52	
实际结余募集资金	F	593.71	
差异[注]	G=E-F	122.81	

[注]差异一部分系公司使用自有资金支付 30.95 万元印花税所致，另一部分系无锡伟测半导体科技有限公司集成电路测试产能建设项目和集成电路测试研发中心建设项目全部投资款项支付完成之日时的节余募集资金以及后续产生的利息共计 153.76 万元转一般户补充流动资金所致，故实际募集资金结余较应结余募集资金少 122.81 万元。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》（上证发〔2023〕194 号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《上海伟测半导体科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同

保荐机构方正证券承销保荐有限责任公司、子公司无锡伟测半导体科技有限公司和南京伟测半导体科技有限公司于 2022 年 10 月 21 日、2022 年 12 月 8 日分别与交通银行、平安银行、兴业银行、浦发硅谷银行、招商银行、光大银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》或《募集资金专户存储四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本公司有 2 个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

单位：人民币元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
光大银行无锡分行营业部	39920180800378858	4,808,054.52	募集资金专户余额
交通银行南京鼓楼支行	320006600013002774567	1,129,091.65	募集资金专户余额
合计		5,937,146.17	

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。

（二）募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

（三）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

1、无锡伟测半导体科技有限公司集成电路测试产能建设项目，2023 年 7 月达到预定可使用状态，因此在 2023 年 1-12 月不构成完整会计年度，故不适用承诺效益评价。

2、集成电路测试研发中心建设项目无法单独核算效益，公司拟通过该项目进一步购置先进的研发及实验设备，对公司现有核心技术、主要产品以及战略规划中未来拟研发的新技术、新产品及新兴应用领域进行长期深入的研究和开发。

通过该项目改善研发环境，提升对人才的吸引力，增强公司核心技术优势和产品竞争力。

3、补充流动资金项目无法单独核算效益，该项目涉及生产、营销等多个业务环节，每个环节的提升均会对公司的整体业务发展产生影响，共同支撑公司业务持续稳定增长。

4、“超募资金——伟测半导体无锡集成电路测试基地项目”、“超募资金——伟测集成电路芯片晶圆级及成品测试基地项目”均尚未达到预定可使用状态，暂时无法测算效益。

（四）募投项目先期投入及置换情况

公司于 2022 年 11 月 11 日召开公司第一届董事会第十七次会议、第一届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司或实施募投项目的子公司无锡伟测半导体科技有限公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金人民币 31,830.63 万元及已支付发行费用的自筹资金人民币 370.83 万元，独立董事、监事会及保荐机构对上述使用募集资金置换事项发表了明确同意的意见，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司使用募集资金置换预先投入的自有资金事项进行了鉴证，并出具天健审〔2022〕6-499 号《关于上海伟测半导体科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告》。

截至 2022 年 12 月 31 日，预先投入募集资金投资项目的自筹资金 31,830.63 万元已全部置换；截至 2023 年 12 月 31 日，预先支付的发行费用 370.83 万元已完成置换。

（五）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2023 年度，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（六）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司于 2022 年 11 月 11 日召开第一届董事会第十七次会议及第一届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，

同意公司（含子公司）在保证不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下，使用最高不超过人民币 10 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买投资安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限于结构性存款、大额存单等），独立董事、监事会及保荐机构对本事项发表了同意的意见。

公司于 2023 年 10 月 26 日召开第二届董事会第三次会议及第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司（含子公司）在保证不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下，使用最高不超过人民币 2 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买投资安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限于结构性存款、大额存单等），独立董事、监事会及保荐机构对本事项发表了同意的意见。

截至 2023 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的产品情况详见下表：

银行名称	账户性质	期末余额（元）	购买日	到期日	实际获得收益（元）
浦发硅谷银行有限公司	结构性存款	0	2022/11/23	2023/1/6	33,753.42
浦发硅谷银行有限公司	结构性存款	0	2022/11/23	2023/1/17	84,383.56
申万宏源证券有限公司上海陆家嘴环路营业部	证券收益凭证	0	2022/12/1	2023/2/28	304,794.52
招商银行股份有限公司上海张扬支行	结构性存款	0	2022/12/7	2023/3/8	209,424.66
招商银行股份有限公司上海张扬支行	结构性存款	0	2022/12/29	2023/3/30	137,123.29
兴业银行股份有限公司上海杨浦支行	结构性存款	0	2022/12/1	2023/2/1	445,041.10
兴业银行股份有限公司上海杨浦支行	结构性存款	0	2022/12/9	2023/3/9	665,753.43
中国光大银行股份有限公司无锡分行营业部	结构性存款	0	2022/12/12	2023/1/12	105,000.00
招商银行股份有限公司无锡新区支行	结构性存款	0	2022/12/14	2023/1/16	199,627.40
中信银行无锡新区支行	结构性存款	0	2022/12/15	2023/2/13	108,904.11
招商银行股份有限公司无锡新区支行	结构性存款	0	2022/12/22	2023/1/30	147,452.05
中国光大银行股份有限公司	结构性存款	0	2023/1/12	2023/2/12	137,500.00

司无锡分行营业部					
中国光大银行股份有限公司无锡分行营业部	结构性存款	0	2023/1/12	2023/2/27	165,000.00
中国光大银行股份有限公司无锡分行营业部	结构性存款	0	2023/1/12	2023/3/12	275,000.00
招商银行股份有限公司无锡新区支行	结构性存款	0	2023/1/18	2023/2/20	107,046.58
招商银行股份有限公司无锡新区支行	结构性存款	0	2023/2/1	2023/3/1	115,068.49
中国光大银行股份有限公司无锡分行营业部	结构性存款	0	2023/2/13	2023/3/13	120,833.33
中国光大银行股份有限公司无锡分行营业部	结构性存款	0	2023/3/1	2023/4/1	93,333.33
中国光大银行股份有限公司无锡分行营业部	结构性存款	0	2023/3/13	2023/4/13	114,583.33
中国光大银行股份有限公司无锡分行营业部	结构性存款	0	2023/3/13	2023/4/28	171,875.00
中国光大银行股份有限公司无锡分行营业部	结构性存款	0	2023/4/10	2023/5/10	68,750.00
中国光大银行股份有限公司无锡分行营业部	结构性存款	0	2023/4/26	2023/5/26	78,750.00
中国光大银行股份有限公司无锡分行营业部	结构性存款	0	2023/4/28	2023/5/28	56,250.00
中国工商银行股份有限公司工博园支行	结构性存款	0	2023/5/16	2023/6/20	50,227.40
中国工商银行股份有限公司工博园支行	结构性存款	0	2023/6/2	2023/6/30	32,982.08
中国工商银行股份有限公司南京珠江支行	中国工商银行如意人生随心E专户定制型人民币理财产品	0	2022/12/14	2023/1/18	55,890.41
交通银行南京鼓楼支行	结构性存款	0	2022/12/19	2023/3/23	424,931.51
交通银行南京鼓楼支行	结构性存款	0	2022/12/19	2023/1/19	131,643.84
中信银行南京中山东路支行	结构性存款	0	2022/12/14	2023/3/14	69,041.10
兴业银行股份有限公司上海杨浦支行	结构性存款	0	2023/2/6	2023/4/6	467,150.68
兴业银行股份有限公司上海杨浦支行	结构性存款	0	2023/3/14	2023/5/15	484,657.54
兴业银行股份有限公司上海杨浦支行	结构性存款	0	2023/3/16	2023/4/17	72,871.23
兴业银行股份有限公司上	结构性存款	0	2023/3/31	2023/4/23	34,115.07

海杨浦支行					
交通银行上海张江支行	结构性存款	0	2023/2/2	2023/2/10	28,931.51
交通银行上海张江支行	结构性存款	0	2023/2/13	2023/3/6	13,808.22
交通银行上海张江支行	结构性存款	0	2023/2/13	2023/3/20	115,068.49
交通银行上海张江支行	结构性存款	0	2023/3/9	2023/3/23	8,438.36
交通银行上海张江支行	结构性存款	0	2023/3/27	2023/4/4	28,931.51
交通银行上海张江支行	结构性存款	0	2023/4/6	2023/4/14	28,931.51
交通银行上海张江支行	结构性存款	0	2023/4/27	2023/5/5	16,876.71
兴业银行股份有限公司上海杨浦支行	结构性存款	0	2023/4/10	2023/5/11	234,410.96
兴业银行股份有限公司上海杨浦支行	结构性存款	0	2023/4/19	2023/5/15	51,682.19
兴业银行股份有限公司上海杨浦支行	结构性存款	0	2023/4/24	2023/5/12	23,178.08
申万宏源证券有限公司上海陆家嘴环路营业部	证券收益凭证	0	2023/3/3	2023/6/5	344,863.01
交通银行上海张江支行	结构性存款	0	2023/5/8	2023/5/16	14,465.75
交通银行南京鼓楼支行	结构性存款	0	2023/5/17	2023/6/21	141,438.36
兴业银行股份有限公司上海杨浦支行	结构性存款	0	2023/5/17	2023/6/19	231,013.70
兴业银行股份有限公司上海杨浦支行	结构性存款	0	2023/5/17	2023/6/6	42,739.73
兴业银行股份有限公司上海杨浦支行	结构性存款	0	2023/5/17	2023/8/17	142,158.91
申万宏源证券有限公司上海陆家嘴环路营业部	证券收益凭证	0	2023/6/8	2023/7/10	103,972.60
兴业银行股份有限公司上海杨浦支行	结构性存款	0	2023/6/9	2023/7/10	66,246.57
兴业银行股份有限公司上海杨浦支行	结构性存款	0	2023/6/28	2023/7/24	151,232.88
招商银行股份有限公司无锡新区支行	结构性存款	0	2023/8/10	2023/9/11	138,345.21
中国光大银行股份有限公司无锡分行营业部	结构性存款	0	2023/8/9	2023/9/9	63,750.00
中国光大银行股份有限公司无锡分行营业部	结构性存款	0	2023/9/11	2023/9/25	14,233.33
中国工商银行股份有限公司工博园支行	结构性存款	0	2023/9/14	2023/10/16	77,326.03
招商银行股份有限公司无锡新区支行	结构性存款	0	2023/9/19	2023/10/19	40,438.36
中国光大银行股份有限公司无锡分行营业部	结构性存款	0	2023/10/17	2023/10/30	20,258.33
中国光大银行股份有限公司	结构性存款	0	2023/11/9	2323/12/9	73,500.00

司无锡分行营业部					
兴业银行股份有限公司上海杨浦支行	结构性存款	0	2023/7/12	2023/8/14	65,482.19
兴业银行股份有限公司上海杨浦支行	结构性存款	0	2023/8/21	2023/10/12	180,931.51
申万宏源证券有限公司上海陆家嘴环路营业部	证券收益凭证	0	2023/7/13	2023/9/11	204,726.03
申万宏源证券有限公司上海陆家嘴环路营业部	证券收益凭证	0	2023/9/13	2023/10/31	164,383.56

2023 年度，公司以闲置募集资金进行现金管理取得的收益共计 860.05 万元。

(七) 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

2023 年度，公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

(八) 超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

1、公司于 2022 年 11 月 11 日召开第一届董事会第十七次会议，审议通过《关于使用部分超募资金向全资子公司增资以实施新建项目的议案》，同意公司使用部分超募资金人民币 30,000.00 万元分别向全资子公司无锡伟测半导体科技有限公司增资 15,000.00 万元及向全资子公司南京伟测半导体科技有限公司增资 15,000.00 万元，分别用于投资建设新项目“伟测半导体无锡集成电路测试基地项目”及“伟测集成电路芯片晶圆级及成品测试基地项目”，独立董事、监事会及保荐机构对本事项发表了同意的意见。2022 年 11 月 28 日，公司召开 2022 年第三次临时股东大会审议通过上述议案。截至 2022 年 12 月 31 日，公司向募投项目“伟测半导体无锡集成电路测试基地项目”（以下简称“该募投项目”）的募集资金专项账户转入超募资金 5,000 万元，公司向募投项目“伟测集成电路芯片晶圆级及成品测试基地项目”的募集资金专项账户转入超募资金 15,000 万元；报告期内，公司向该募投项目的募集资金专项账户转入本议案审议通过的剩余的超募资金 10,000 万元。

2、公司于 2023 年 4 月 19 日召开了第一届董事会第十八次会议，审议通过了《关于使用超募资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的议案》，同意公司使用超募资金人民币 10,000.00 万元向全资子公司南京伟测提供借款，用于继

续实施募投项目“伟测集成电路芯片晶圆级及成品测试基地项目”，独立董事、监事会及保荐机构对本事项发表了同意的意见。2023年5月11日，公司召开2022年年度股东大会审议通过上述议案。股东大会审议通过本议案后，公司已向南京伟测转入本次议案审议的借款金额用于实施募投项目“伟测集成电路芯片晶圆级及成品测试基地项目”。

3、公司于2023年6月30日召开了第一届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于使用超募资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的议案》，同意公司使用超募资金人民币10,000.00万元向全资子公司无锡伟测提供借款，用于继续实施募投项目“伟测半导体无锡集成电路测试基地项目”，独立董事、监事会及保荐机构对本事项发表了同意的意见。2023年7月18日，公司召开2023年第一次临时股东大会审议通过上述议案。股东大会审议通过本议案后，公司已向无锡伟测转入本次议案审议的借款金额用于实施募投项目“伟测半导体无锡集成电路测试基地项目”。

4、公司于2023年10月26日召开了第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于使用超募资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的议案》，同意公司将剩余超募资金133,474,873.89元及孳息向全资子公司南京伟测提供借款，用于继续实施募投项目“伟测集成电路芯片晶圆级及成品测试基地项目”，独立董事、监事会及保荐机构对本事项发表了同意的意见。2023年11月14日，公司召开2023年第二次临时股东大会审议通过上述议案。股东大会审议通过本议案后，公司已向南京伟测转入本次议案审议的借款金额用于实施募投项目“伟测集成电路芯片晶圆级及成品测试基地项目”。

（九）节余募集资金使用情况

无锡伟测半导体科技有限公司集成电路测试产能建设项目已于2023年上半年完成全部投资款项支付，并于2023年7月达到预定可使用状态，截至该项目全部投资款项支付完成之日，节余募集资金（包括利息收入）共计120.47万元，公司已将节余募集资金（包括后续产生的利息）从募集资金专户转出至一般户并用于补充流动资金，2023年7月公司已将该募集资金专户销户。公司节余募集资金的使用符合《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范

运作》《管理制度》等相关规定。

集成电路测试研发中心建设项目已于 2023 年上半年完成全部投资款项支付，并于 2023 年 8 月达到预定可使用状态，截至该项目全部投资款项支付完成之日，节余募集资金（包括利息收入）共计 32.91 万元。公司已该募集资金专户销户，销户时公司将相关节余募集资金（包括后续产生的利息）从募集资金专户转出至一般户并用于补充流动资金。公司节余募集资金的使用符合《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《管理制度》等相关规定。

（十）募集资金使用的其他情况

2023 年度，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

（一）变更募集资金投资项目情况表

本年度不存在变更募集资金投资项目的情况。

（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

1、募集资金投资项目对外转让情况说明

本年度不存在募集资金投资项目发生对外转让的情况。

2、募集资金投资项目置换情况说明

本年度不存在募集资金投资项目发生置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

天健会计师事务所（特殊普通合伙）认为：伟测科技公司管理层编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监

会公告〔2022〕15号）和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2023年12月修订）》（上证发〔2023〕194号）的规定，如实反映了伟测科技公司募集资金2023年度实际存放与使用情况。

七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

经核查，保荐机构认为：伟测科技2023年度募集资金存放和使用符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。保荐机构对伟测科技2023年度募集资金存放与使用情况无异议。

八、上网公告附件

1、天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司2023募集资金年度存放与使用情况鉴证报告及说明（天健审〔2024〕6-21号）；

2、方正证券承销保荐有限责任公司关于公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见。

九、其他

附件：募集资金使用情况对照表

特此公告。

上海伟测半导体科技股份有限公司

董事会

2024年3月22日

附件 1

募集资金使用情况对照表

2023 年度

编制单位：上海伟测半导体科技股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额				123,717.95		本年度投入募集资金总额				88,884.21		
变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额				124,314.89		
变更用途的募集资金总额比例												
承诺投资项目	是否已变更项目（含部分变更）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%) (4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
无锡伟测半导体科技有限公司集成电路测试产能建设项目	否	48,828.82	48,828.82	48,828.82	16,961.43	48,797.15	-31.67	99.94%	2023 年 7 月	14,030.35	不适用	否

集成电路测试研发中心建设项目	否	7,366.92	7,366.92	7,366.92	6,106.67	7,408.42	41.50[注 1]	100.56% [注 1]	2023 年 8 月	不适用	不适用	否
补充流动资金	否	5,000.00	5,000.00	5,000.00	3,101.56	5,019.70	19.70[注 1]	100.39% [注 1]	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计	—	61,195.74	61,195.74	61,195.74	26,169.66	61,225.27	29.53	—	—	—	—	—
超募资金项目												
超募资金-伟测半导体无锡集成电路测试基地项目	否	15,000.00	25,000.00 [注 2]	25,000.00	24,737.17	24,737.17	-262.83	98.95%	2027 年 10 月	不适用	不适用	否
超募资金-伟测集成电路芯片晶圆级及成品测试基地项目	否	15,000.00	38,347.49 [注 3]	38,347.49	37,977.38	38,352.45	4.96 [注 1]	100.01% [注 1]	2024 年 12 月	不适用	不适用	否

超募资金项目小计		30,000.00	63,347.49	63,347.49	62,714.55	63,089.62	-257.87	—	—	—	—	—
合计	—	91,195.74	124,543.23	124,543.23	88,884.21	124,314.89	-228.34	—	—	—	—	—
未达到计划进度原因（分具体项目）	不适用											
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用											
募集资金投资项目先期投入及置换情况	公司于 2022 年 11 月 11 日召开公司第一届董事会第十七次会议、第一届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司或实施募投项目的子公司无锡伟测半导体科技有限公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金人民币 31,830.63 万元及已支付发行费用的自筹资金人民币 370.83 万元；截至 2023 年 12 月 31 日，预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金共计 32,201.46 万元已全部置换。											
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用											
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况	公司于 2022 年 11 月 11 日召开第一届董事会第十七次会议及第一届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司（含子公司）在保证不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下，使用最高不超过人民币 10 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买投资安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限于结构性存款、大额存单等）。 公司于 2023 年 10 月 26 日召开第二届董事会第三次会议及第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司（含子公司）在保证不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下，使用最高不超过人民币 2 亿元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买投资安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限于结构性存款、大额存单等）。											
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用											

募集资金结余的金额及形成的原因	无锡伟测半导体科技有限公司集成电路测试产能建设项目已于 2023 年上半年完成全部投资款项支付，截至该项目全部投资款项支付完成之日，节余募集资金（包括利息收入）共计 120.47 万元；集成电路测试研发中心建设项目已于 2023 年上半年完成全部投资款项支付，截至该项目全部投资款项支付完成之日，节余募集资金（包括利息收入）共计 32.91 万元。上述节余募集资金的形成原因如下：公司在项目实施过程中严格按照募集资金使用的有关规定，从项目的实际情况出发，在保证募投项目建设质量的前提下，合理审慎地使用募集资金，加强项目建设各个环节费用的控制、监督和管理，降低项目建设成本和费用。为提高募集资金的使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金安全的前提下，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理获得了一定的投资收益，同时募集资金存放期间也产生了一定的存款利息收入。受账户利息因素影响，上述节余募集资金数额在募资资金专户销户转出至一般账户时的合计总额为 153.76 万元。
募集资金其他使用情况	不适用

[注 1]集成电路测试研发中心建设项目、补充流动资金项目募集资金累计投入进度大于 100%系使用了募集资金的利息收入。

[注 2]本公司于 2023 年 6 月 30 日召开第一届董事会第二十一次会议及第一届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用超募资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的议案》，同意公司使用部分超募资金人民币 10,000.00 万元向全资子公司无锡伟测提供借款，用于继续实施募投项目“伟测半导体无锡集成电路测试基地项目”，独立董事、监事会及保荐机构对本事项发表了同意的意见。上述借款事项经公司股东大会审议通过，公司累计使用部分超募资金 25,000.00 万元实施该项目。

[注 3]本公司于 2023 年 4 月 19 日召开第一届董事会第十八次会议及第一届监事会第九次会议，审议通过《关于使用超募资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的议案》，同意公司使用部分超募资金人民币 10,000.00 万元向全资子公司南京伟测提供借款，用于继续实施募投项目“伟测集成电路芯片晶圆级及成品测试基地项目”，独立董事、监事会及保荐机构对本事项发表了同意的意见。本公司于 2023 年 10 月 26 日召开第二届董事会第三次会议，审议通过《关于使用超募资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的议案》，同意使用剩余超募资金 133,474,873.89 元及孳息向全资子公司南京伟测提供借款以继续实施募投项目，独立董事、监事会及保荐机构对上述事项发表了同意的意见。上述借款事项经公司股东大会审议通过，公司累计使用部分

超募资金 38,347.49 万元实施该项目。

[注 4]无锡伟测半导体科技有限公司集成电路测试产能建设项目本年实现的效益 14,030.35 万元为实现的收入。